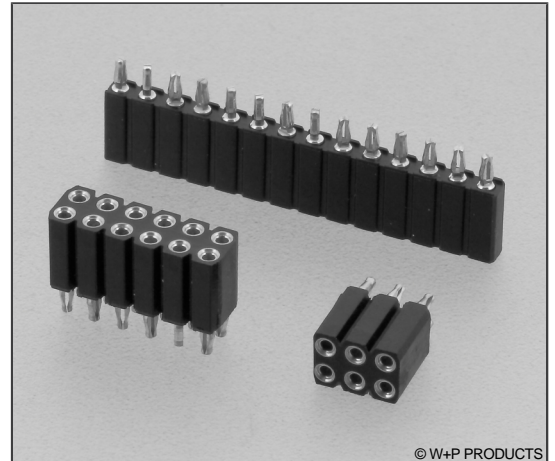


153PF

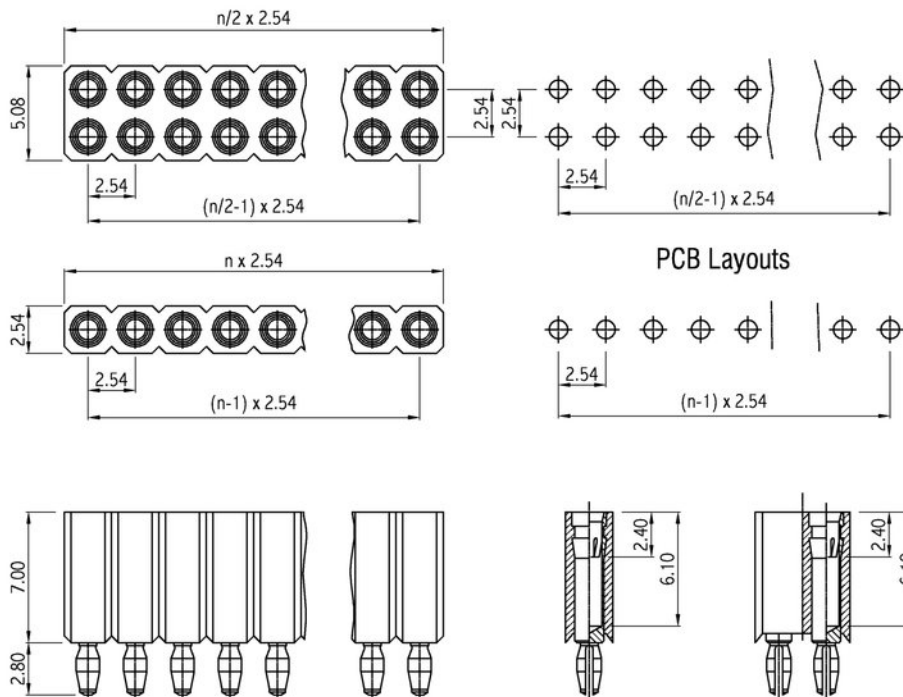
Press-Fit Präz.-Buchsenleisten RM 2,54mm, 1-/2-reihig Press-Fit Precision Female Headers, 2.54mm Pitch, Single/Double Row

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Hülse: Phosphorbronze gedreht Feder: 6-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer
Contact Material	Sleeve: screw machined phosphor bronze Clip: 6-Finger-Clip, Beryllium-Copper
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
Contact Resistance	< 10 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	1 kV RMS
Test Voltage	1 kV RMS
Nennstrom	3 A
Current Rating	3 A
Temperaturbereich	-55 °C ... +125 °C
Temperature Range	-55 °C ... +125 °C



Einsetzbar für Rundstifte Ø0,65-0,85mm oder Vierkantstifte 0,635mm. Auf Anfrage für Rundstifte Ø0,40-0,56mm oder Vierkantstifte 0,40x0,25mm erhältlich.
Accept round pins Ø0.65-0.85mm or 0.635mm square pins.
Also available on request for Ø0.40-0.56mm round pins or 0.40x0.25mm rectangular pins.



Einpresszone s. Tech. Informationen.
See technical information for PressFit zones.

Series	Contacts*	Rows*	Sleeve Plating	Clip Plating*
153PF	010	1	50	00
	002-050 Einreihig Single row 004-100 Zweireihig Double row	1 Einreihig Single row 2 Zweireihig Double row	50 Hülse verzinkt Tin plated sleeve	00 Feder vergoldet Gold plated clip 10 Feder 0,25µm Gold (Option) 0.25µm gold plated clip (Option) 30 Feder 0,75µm Gold 0.75µm gold plated clip 50 Feder verzinkt Tin plated clip

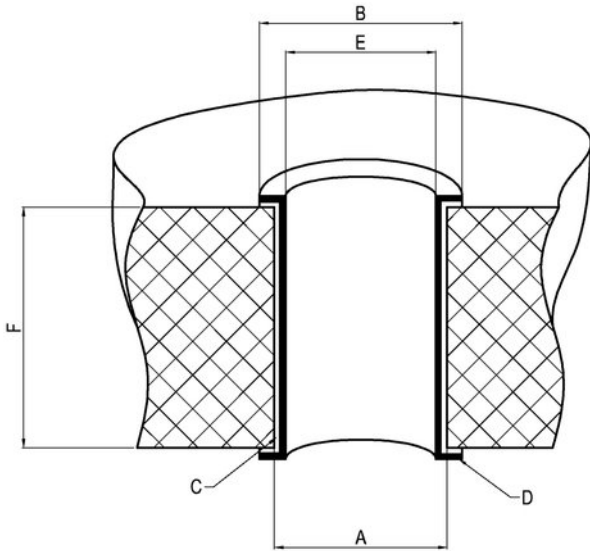
* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

PressFit Lochdefinitionen

PressFit Hole Definitions

Empfohlene Maße der Einpresszonen unserer PressFit Stift- und Buchsenleisten

Recommended Dimensions of PressFit Through Holes



A	Bohrungs-Ø	Base Hole Ø
B	Ring-Ø	Ring Ø
C	Cu-Schicht	Cu Layer
D	Veredelung	Plating
E	Endloch-Ø	Final Hole Ø
F	Leiterplattendicke	PCB Thickness

Serie Series	RM / Pitch [mm]	A [mm]	B [mm]	C [µm]	D Option [µm]		E [mm]	F [mm]
					Sn	Au/Ni		
943PF, 944PF 943PFS, 944PFS	2,54	1,15±0,03	min. 1,35	min. 25	max. 1,5 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	1,00 ^{+0,09} _{-0,06}	min. 1,60
314PF	2,00	0,89±0,03	min. 1,30	min. 30	max. 1,5 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	0,81±0,05	min. 1,60
153PF	2,54	1,15±0,03	min. 1,35	min. 25	5~15 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	1,00 ^{+0,09} _{-0,06}	min. 1,60
153PF-38	2,54	1,15±0,03	min. 1,35	min. 25	5~15 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	1,00 ^{+0,09} _{-0,06}	min. 2,50
182PF	2,54	1,15±0,03	min. 1,35	min. 25	max. 1,5 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	1,00 ^{+0,09} _{-0,06}	min. 1,60
138PF	2,54	1,15±0,03	min. 1,35	min. 25	max. 1,5 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	1,00±0,05	min. 1,60